

古河電気工業(株) 事業 IR 説明会 質疑応答録 (要旨)

日時：2022年6月10日(金) 14:15-15:00

内容：機能製品事業

説明者：執行役員常務 機能製品統括部門長 大野 良次

陪席者：執行役員 AT・機能樹脂事業部門長 矢野 正三

サーマル・電子部品事業部門長 本村 拓也

メモリーディスク事業部門長 宮崎 秀彦

銅箔事業部門長 徳原 直文

機能製品統括部門企画統括部長 齊藤 孝史

取締役兼執行役員常務 財務本部長 福永 彰宏

Q：半導体製造用テープについて。これまでほとんど設備投資は行っていないと思うが、市場や顧客層の拡大など投資を決めた背景について教えてほしい。

A：これまでの半導体メモリ用途だけでなく、ロジック半導体向け含めて顧客層を広げていく。

Q：機能製品全体として 25 年度に向けて意欲的な計画を掲げているが、主要製品の成長シナリオについて教えてほしい。また、過去に比べて需要環境も良くなっていると思うが、ここ数年で変化したポイントは何か？

A：半導体テープは、メモリ用途以外も含めて半導体の高機能化に対応していく。サーマル製品は顧客の AI プロジェクトなどにより市場が拡大していくなか、差別化製品を提供していく。個々の事業・製品ごとに（成長に向けた）対応を行っていく。特に注力している市場はデータセンタ含めた IT インフラ関係。これまで開発してきた製品の拡大、製造能力が不足している製品は必要な投資も行っていく。サーマル製品のフィリピン拠点もその一例。

Q：半導体製造用テープは 25 年度に向けて（21 年度比）売上 1.8 倍を目標にしているが、既に受注がみえているのか？また、利益率もさらに向上するのか？

A：5G、IoT、スマートシティなどが主な需要拡大の背景。潜在的な成長市場が、コロナによるステイホーム等もあり一気に拡大し、顧客要望に応えるために設備投資を決定した。25 年 4 月に量産開始予定だが、一気にフル生産になるのではなく、その後の需要増への対応もふまえ投資を計画した。今後の利益率向上も図れるものと考えている。

Q：機能樹脂製品や電池用銅箔は、汎用製品といったイメージがあるが競争優位性はあるのか？ ROIC 向上を鑑みて、事業・製品として縮小していくものはあるのか？

A：今後も状況をみながら（各事業・製品の取捨選択を）決めていく。メモリーディスクは厚型製品をいつまで継続するか、サーマル製品はパソコン用ヒートパイプをほぼやめていく方向など、状況に応じて必要なタイミングで判断を行っていく。銅箔や機能樹脂製品についても、同様に判断する。

Q：銅箔は日系の同業他社も高周波用回路箔に注力するようだが、差別化ポイントは？

A：直接の顧客である CCL メーカー各々が持っている独自の樹脂との擦り合わせ・連携が重要。これらに対するカスタマイズ対応力に強みを持っている。

Q：メモリーディスクは、製品ミックス改善の一方で新製品対応によるコスト増もあると思うが、今後も適切な収益を得られるのか？

A：メモリーディスクは薄型製品で適切な利益率が得られるため、薄型シフトによる収益性向上が可能。

Q：銅箔のカーボンニュートラル対応は、顧客から選ばれるための条件として評価されているのか？

A：顧客による採用増のトリガーとして、カーボンニュートラル対応は今始まったところという感触であり、顧客からの問合せが増加している。カーボンニュートラル対応への北米等の最終顧客の本気度は高く、今後我々が対応しないという選択肢はなくなるとみており、鋭意対応を進めている。

Q：メモリーディスクは高容量品中心にガラス化が進んでいると思うが、アルミの需要はどのぐらい続くとみているのか？
ガラス化により需要がなくなることはないのか？

A：ガラス化進展は何年も前から言われているが、価格、供給対応力、取り扱い性、また最終顧客がアルミメッキ工程の投資を実施しているなどもあり、アルミ需要は今後も継続するものとみている。

以上